

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2018年5月3日(03.05.2018)



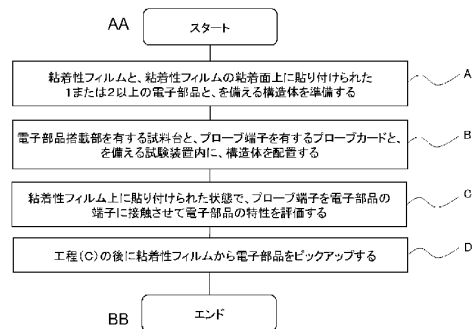
(10) 国際公開番号

WO 2018/079551 A1

- (51) 国際特許分類:
G01R 31/26 (2014.01) H01L 21/301 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01) H01L 21/66 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2017/038365
- (22) 国際出願日: 2017年10月24日(24.10.2017)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2016-210616 2016年10月27日(27.10.2016) JP
- (71) 出願人: 三井化学東セロ株式会社
(MITSUI CHEMICALS TOHCELLO, INC.) [JP/
- JP]; 〒1018485 東京都千代田区神田美
土代町7 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 林 下 英 司 (HAYASHISHITA Eiji);
〒4570801 愛知県名古屋市南区丹後通2-1
三井化学東セロ株式会社内 Aichi (JP).
- (74) 代理人: 速水 進治 (HAYAMI Shinji); 〒1410031
東京都品川区西五反田7丁目9番2号 K
DX五反田ビル9階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH,

(54) Title: ELECTRONIC DEVICE PRODUCTION METHOD, ADHESIVE FILM FOR ELECTRONIC DEVICE PRO-
DUCTION, AND ELECTRONIC COMPONENT TESTING DEVICE

(54) 発明の名称: 電子装置の製造方法、電子装置製造用粘着性フィルムおよび電子部品試験装置



- A Prepare structure provided with adhesive film and one or more
electronic components attached to adhesive surface of adhesive film
- B Place structure within testing device equipped with sample stage having
electronic component placement section and probe card having probe terminals
- C Evaluate properties of electronic component by bringing probe terminals into contact
with terminals of electronic component while electronic component is attached to
adhesive film
- D Pick up electronic component from adhesive film following step (C)
- AA Start
- BB End

(57) Abstract: This electronic device production method includes: a step (A) for preparing a structure which is provided with an adhesive film and one or more electronic components attached to the adhesive surface of the film; a step (B) for placing the structure within an electronic component testing device equipped with a sample stage which has an electronic component placement region and a probe card which is provided in a position opposite the sample stage and which is

[続葉有]

WO 2018/079551 A1

KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

provided with probe terminals, the structure being placed in the electronic component testing device such that the electronic component is positioned upon the electronic component placement region of the sample stage with the adhesive film therebetween; a step (C) for evaluating the properties of the electronic component by bringing the probe terminals into contact with the terminals of the electronic component while the electronic component is attached to the adhesive film; and a step (D) for thereafter picking up the electronic component from the adhesive film. Additionally, in at least step (C), the structure is placed within the border of a frame, the ends of the adhesive film are secured in the frame, and the top surface of the frame is disposed below the top surface of the electronic component placement region of the sample stage in the vertical direction of the sample stage.

(57) 要約: 本発明の電子装置の製造方法は、粘着性フィルムと、その粘着面上に貼り付けられた1または2以上の電子部品と、を備える構造体を準備する工程(A)と、電子部品搭載領域を有する試料台と、試料台に対向する位置に設けられ、かつ、プローブ端子を有するプローブカードと、を備える電子部品試験装置における試料台の電子部品搭載領域上に粘着性フィルムを介して電子部品が位置するように、構造体を電子部品試験装置内に配置する工程(B)と、粘着性フィルム上に貼り付けられた状態で、プローブ端子を電子部品の端子に接触させて電子部品の特性を評価する工程(C)と、その後に粘着性フィルムから電子部品をピックアップする工程(D)と、を備える。そして、少なくとも工程(C)において、構造体はフレームの枠内に配置され、かつ、粘着性フィルムの端部がフレームに固定されており、試料台の垂直方向において、フレームの上面を試料台の電子部品搭載領域の上面よりも下方に配置させる。